

御中

プロダクト／プロセス変更通知書
Product/Process Change Notification (PCN)

件名: i. MX31 19x19パッケージ天津組立工場 銅ワイヤボンディング認定

《お願い》

本変更通知に関してご意見・ご要求のある場合は、作成日より一ヵ月以内に弊社担当営業までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、ご連絡が無い場合は本変更が承認されたと判断させていただきます。



2012年11月14日

フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社

プロダクトマーケティング本部

該当GPCN番号:

15382

変更内容:

i. MX31オートモーティブ品19×19mm MAPBGAパッケージの天津組立工場において銅ワイヤボンディングを認定しました。
ワイヤボンディングの材料以外の変更はありません。
FIT、機能、信頼性にも影響はありません。

変更理由:

銅配線をワイヤ・ボンド材料に追加。

対象製品:

MCIMX31LCVMN4D
MCIMX31CVMN4D
MCIMX31CJMN4C
MCIMX31CJMN4CR2
MCIMX31CJMN4D
MCIMX31CVMN4CR2
MCIMX31LCVMN4C
SCIMX31LCVMF4CR2
SCIMX31LCVMF4C
MCIMX31CVMN4C

変更（変更品出荷）時期:

変更開始日： 2013年2月11日

この期日をもちまして、従来品に加え、銅ワイヤボンディング品の出荷を順次開始いたします。
出荷日を特定することはできません。

変更品の見分け方:

製品名、捺印に変更はありません。
捺印上の組立工場コード・デートコードを含むトレーサビリティコードで追跡できる管理をしています。

その他:

